

水晶振動子片 / Crystal Blanks



公称周波数 Nominal frequency	3.2 [MHz] ~ 155 [MHz] (サードオーバートーン) 3.2 [MHz] ~ 155 [MHz] (3rd Overtone)
切断角度精度 Cutting angle accuracy	±30 [秒] ~ ±2 [分] ±30 [seconds] ~ ±2 [minutes]
水晶片サイズ Blank size	0.8 x 0.4 [mm] ~ 8.0 x 2.5 [mm]
形状 Shape	コンベックス、ベベル、メサ、平板 Convex type, Bevel type, Mesa type, Flat plate type
表面仕上げ Finishing of surface	#3000-エッチング、#4000-エッチング、ポリッシュ #3000-Etching, #4000-Etching, Polish

水晶デバイス / Crystal Devices

音叉型水晶振動子 / Tuning Fork Crystal Units

Model	Size (Max.mm)	Freq. Range (kHz)	Type
CFS-145	 Φ:1.5 x H:5.1	32.768	シリンダー スルーホール Cylinder / Through hole
CFS-206	 Φ:2.1 x H:6.2	32.768	シリンダー スルーホール Cylinder / Through hole
CFV-206	 Φ:2.1 x H:6.2	30 ~ 100	シリンダー スルーホール Cylinder / Through hole
CMR200T	 Φ:2.1 x H:6.1	32.768	シリンダーリードフォーミング 表面実装 Cylinder / Lead formed SMD
CMJ206T	 L:8.6 x W:2.7 x H:2.4	32.768	シリンダー ジャケットタイプ 表面実装 Cylinder / With jacket SMD
CM250C	 L:8.0 x W:3.8 x H:2.55	30 ~ 100	樹脂モールド 表面実装 Plastic mold / SMD
CM200C	 L:8.0 x W:3.8 x H:2.55	32.768	樹脂モールド 表面実装 Plastic mold / SMD
CM130	 L:7.0 x W:1.5 x H:1.4	32.768	樹脂モールド 表面実装 Plastic mold / SMD
CM519	 L:5.05 x W:1.95 x H:1.0	32.768	セラミックパッケージ 表面実装 Ceramic package / SMD
CM415	 L:4.2 x W:1.6 x H:0.9	32.768	セラミックパッケージ 表面実装 Ceramic package / SMD
CM315D	 L:3.3 x W:1.6 x H:0.9	32.768	セラミックパッケージ 表面実装 Ceramic package / SMD
CM315DL	 L:3.3 x W:1.6 x H:0.9	32.768	CM315D 低ESR Ver. (50KΩ Max.) Low ESR Ver. of CM315D (50KΩ Max.)
CM315E	 L:3.3 x W:1.6 x H:0.9	32.768	3端子 リッドカバー-GND接続 3 pads / Lid cover connected to GND
CM2012H	 L:2.15 x W:1.3 x H:0.6	32.768	セラミックパッケージ 表面実装 Ceramic package / SMD
CM1610H	 L:1.7 x W:1.1 x H:0.5	32.768	セラミックパッケージ 表面実装 Ceramic package / SMD

● パーツナンバーシステム / Part Numbering System

